



プレスリリース

2016年5月30日

ラティス、モバイル・イメージセンサおよびディスプレイ向けに初のプログラマブル ASSP (pASSP) インターフェースブリッジを発表

最高の帯域幅、最小の消費電力、最小限のフットプリントを実現する低コストのビデオインターフェースブリッジ

- モバイルアプリケーションプロセッサ、イメージセンサ、およびディスプレイ間のインターフェースのミスマッチを解消する、業界初のプログラマブルブリッジデバイス
- ASSP が持つ機能性と効率性という特長に加え、柔軟性と製品開発の迅速化という FPGA の長所を融合した、まったく新しいプログラマブル ASSP という製品カテゴリー
- バーチャルリアリティ (VR)、ドローン、カメラ、ウェアラブル機器、モバイル機器、ヒューマンマシンインターフェース (HMI) など、さまざまなアプリケーションに最適

ラティスセミコンダクター (NASDAQ : LSCC) の日本法人、ラティスセミコンダクター株式会社 (東京都品川区、代表取締役：竹原茂昭、以下：ラティス) は本日、モバイル機器のイメージセンサやディスプレイの主要プロトコルをサポートする業界初のプログラマブルブリッジングデバイス、「Lattice CrossLink™」を発表しました。カメラやディスプレイを内蔵したシステムは、多くの場合、相互のインターフェースの種類やレーン数が一致せず、ブリッジを使って接続性の問題を解決しています。この新デバイス CrossLink は、柔軟性と製品開発の迅速化という FPGA の長所と、ASSP が持つ機能性と効率性という特長を併せ持った、プログラマブル ASSP (pASSP) というまったく新しいカテゴリーの製品です。このカテゴリーでは初の製品である CrossLink デバイスは、最高の帯域幅、最小の消費電力、最小限のフットプリントを実現する低コストのビデオインターフェースブリッジで、VR ヘッドセット、ドローン、スマートフォン、タブレット、カメラ、ウェアラブル機器、ヒューマンマシンインターフェース (HMI) などに最適なソリューションです。

CrossLink の機能：

- 12Gbps の帯域幅で最高 4K UHD の解像度に対応する、世界最速 MIPI® D-PHY ブリッジデバイス
- MIPI D-PHY、MIPI CSI-2、MIPI DSI、MIPI DPI、CMOS、SubLVDS、LVDS など、一般的なモバイル、カメラ、ディスプレイ、レガシーのインターフェースをサポート
- 最小 6 mm² オプションを含む業界最小パッケージを提供
- 最低消費電力のプログラマブルブリッジソリューション
- スリープモード対応
- ASSP と FPGA の長所を活かしたベストソリューション

フューチャーソース・コンサルティング、エンターテインメントコンテンツおよび配信部門、アソシエイト・ディレクターのカール・ヒバート(Carl Hibbert)氏は次のようにコメントしています。

「ドローンや VR システムを含むイメージキャプチャとディスプレイなどの最新テクノロジーの登場は、業界に大きな刺激を与えています。これらの新しい技術は、現在全世界ベースで 37 億台のスマートフォンとタブレット市場と合わせると、2020 年までには 30 パーセント増の成長が見込まれています。これらの新技術は、内部の様々なインターフェースをつなぐ必要があります。これらのインターフェースを、低コスト、省電力そして小さな実装面積でブリッジするソリューションは必須となります」

ビデオ接続のギャップを埋める

イメージセンサアプリケーション

ラティスの CrossLink ブリッジは、複数のイメージセンサからプロセッサの単一入力に多重化、統合、アービトラートすることができます。またハイエンドの産業用センサと一般的な A/V イメージセンサをモバイルアプリケーションプロセッサにつなぐことができます。これは、ドローン、拡張現実製品などに加え、360 度全方位カメラ、アクションカム、監視カメラやデジタル一眼レフ (DSLR) カメラなどにも最適です。

ディスプレイアプリケーション

CrossLink デバイスを使うことで、1 つの MIPI DSI インターフェースからビデオデータを受信し、半分の帯域幅で 2 つの MIPI DSI インターフェースに送信することが可能です。同一のビデオストリームは 2 つのインターフェースに分割することができるため、VR ヘッドセットやモバイルのセットトップボックスに最適です。また、RGB または LVDS インターフェースを持つ民生用および産業用パネルをモバイルアプリケーションプロセッサと接続することもできます。CrossLink ブリッジは、HMI、スマートディスプレイ、スマートホーム製品などにむけて、MIPI DPI から、複数レーンの CMOS、LVDS インターフェース、OpenLDI ならびに独自インターフェースへ変換することができます。

ラティスセミコンダクターのコンシューマー製品マーケティング担当シニアディレクターである C.H. Chee は次のように語っています。「CrossLink ブリッジは、ビデオ技術に対し、FPGA の柔軟性と ASSP のパフォーマンスを有しています。この製品は、高速かつ柔軟性の高いイノベーションを求める成長著しいハイボリューム市場向けにさまざまなアプリケーションを取り揃えており、1 台のデバイス内部で多種多様の非互換性インターフェースの増大という課題を解決します」

供給状況

CrossLink 評価ボードは、ラティスおよび正規代理店からご購入になれます。量産デバイスの出荷は間もなく開始されます。詳細については、<http://www.latticesemi.com/CrossLink> をご覧ください。

ラティスセミコンダクターについて

ラティスセミコンダクター (NASDAQ : LSCC) は、低消費電力 FPGA、ビデオ ASS、広帯域幅 60 GHz のミリ波のスマートなコネクティビティソリューション、および IP 製品を、世界中の民生、通信、産業、自動車市場に提供しています。当社のゆるぎないコミットメントは、お客様のイノベーションを加速させ、コネクテッドワールドの実現に貢献します。

より詳しい情報については、www.latticesemi.com をご覧ください。また [LinkedIn](#)、[Twitter](#)、[Facebook](#)、[YouTube](#) または [RSS](#) で当社をフォローしていただくことも可能です。

###

Lattice Semiconductor Corporation、Lattice Semiconductor (およびデザイン)、CrossLink、pASSP および各製品デザインは、米国およびその他の国におけるラティスセミコンダクターまたはその子会社の登録商標もしくは商標です。MIPI®は MIPI Alliance が所有する登録商標です。

一般的注意事項：本リリース内で使用されているその他の製品名は提示のみを目的としており、各社の商標となっているものがあります。